

基板取付け寸法 (参考例)

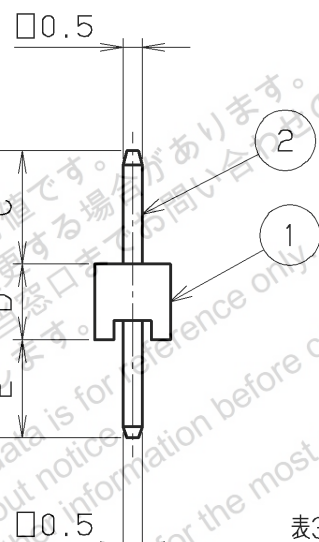
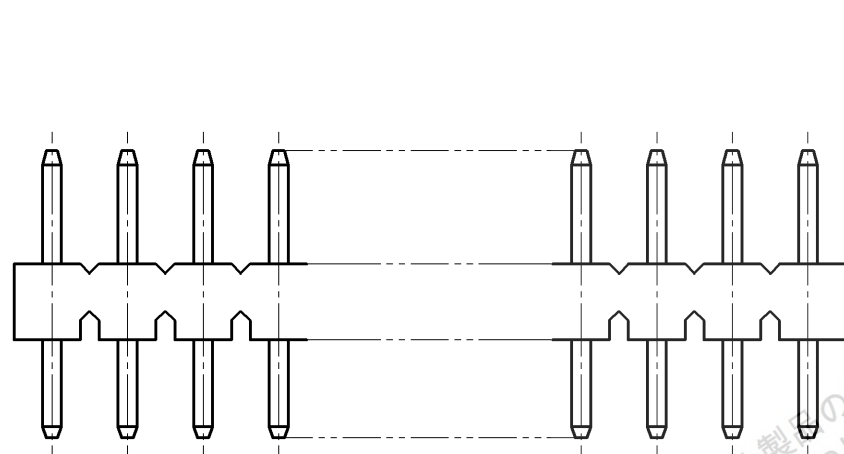


表2

製番	C	D	(E)	F
LPC-()MG()	3±0.3	2±0.2	2.6	7.6±0.3
LPC-()T3MG()	3±0.3	2±0.2	1.65	6.65±0.3
LPC-()T4MG()	3±0.3	2±0.2	4.5	9.5±0.3
LPC-()T5MG()	8±0.3	2±0.2	2.6	12.6±0.3
LPC-()T6MG()	7.5±0.3	2±0.2	2.6	—
LPC-()T7MG()	4±0.3	2±0.2	2.5	8.5±0.3
LPC-()T8MG()	5.5±0.3	2±0.2	1	8.5±0.3
LPC-()T9MG()	8±0.25	2±0.2	2	12±0.3
LPC-()T10MG()	9±0.3	2±0.2	2.6	13.6±0.3
LPC-()T12MG()	10±0.3	2±0.2	2.6	14.6±0.3
LPC-()T13MG()	12.4±0.3	2±0.2	2.6	17±0.3
LPC-()T14MG()	3±0.3	2±0.2	5	10±0.3
LPC-()T15MG()	15.2±0.3	2±0.2	2.6	19.8±0.3
LPC-()T16MG()	3±0.3	2±0.2	9.6	14.6±0.3
LPC-()T18MG()	3±0.3	2±0.2	1.8	6.8±0.3
LPC-()T19MG()	8.5±0.3	2±0.2	2.5	13±0.3
LPC-()T20MG()	3.5±0.3	2±0.2	2.5	8±0.3
LPC-()T21MG()	6±0.3	2±0.2	1.5	9.5±0.3
LPC-()T22MG()	13.6±0.3	2±0.2	2.5	18.1±0.3
LPC-()T23MG()	5.4±0.3	2±0.2	2.6	10±0.3

表3. コンタクト表面処理

製番	コンタクト処理
LPC-(n)()MG	金めっき 0.2μm
LPC-(n)()MG1	金めっき 0.1μm
LPC-(n)()MG2	金めっき 0.05μm

表1

芯数 (n)	A±0.15	B±0.3
1	—	(2)
2	2	4
3	4	6
4	6	8
5	8	10
6	10	12
7	12	14
8	14	16
9	16	18
10	18	20
11	20	22
12	22	24
13	24	26
14	26	28
15	28	30
16	30	32
17	32	34
18	34	36
19	36	38
20	38	40
21	40	42
22	42	44
23	44	46
24	46	48
25	48	50
26	50	52
27	52	54
28	54	56
29	56	58
30	58	60

- 注1. 寸法は表1を参照願います。
 2. 図中“n”は芯数を示します。
 3. 多芯の製品を各芯数に切断し納入致します。

△										
△				2	コンタクト	りん青銅	n	表3記載		
△	080902	小田	改版	1	絶縁体	66ナイロン	1		UL94V-0 黒色	
改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考	
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
11.06	(1984)	5/1		mm (INCH)	3RD. A. P	名称 雄コネクタ (RoHS対応品)				
製	図	設	計	検	図	検	図	承	認	名
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	NAME				製	番
小田	小田	—	布川	海老原	PART NO.				LPC-() () MG ()	